



臻鼎再登SEMICON Taiwan 2025 揭示PCB跨半導體新格局 研華助力打造AI智能園區 共築智慧與綠色製造新典範

全球PCB領導大廠臻鼎科技股份有限公司（股票代號：4958）今（10）日再度參展SEMICON Taiwan 2025，以「PCB跨足半導體」的產業先驅者之姿，展現最新戰略布局。臻鼎表示，此次參展不僅是研發成果的具體展現，更是產業地位的宣告，象徵公司由PCB領導者，進一步成為半導體產業鏈的重要推手，為AI應用發展注入源源不絕的能量。

董事長沈慶芳表示，全球正處於數據爆炸、算力飆升的關鍵時刻。根據全球計算聯盟最新的《異構算力協同白皮書》，2021年全球算力規模為615E FLOPS，2030 年將增長至56Z FLOPS，年複合成長率高達65.1%，顯現算力已成為驅動產業發展的核心引擎。他強調，AI是推動PCB產業成長的重要動能，隨著半導體製程持續演進，PCB承擔起支撐高效能應用的關鍵任務，如此次參展SEMICON的技術，有28層的高階載板、138 x138mm的超大載板、專為AI伺服器打造的HLC+HDI等，都是為了回應市場對高速傳輸與高效能運算的迫切需求。

隨著晶片複雜度提升及 3D 封裝普及，PCB 已不再只是電路載體，而是決定算力能否完全釋放的重要環節。尤其許多 AI 應用對 PCB 有高頻、高速、高密度、高可靠性及低能耗的嚴苛要求，單一製程已難以滿足需求，如何將高階IC載板、高階HDI/MSAP類載板、HLC厚大板等不同製程整合，將成為實現效能突破的關鍵。臻鼎將以「One ZDT」為核心，全面佈局AI時代的「雲、管、端」應用，提供客戶最完整的解決方案，並以AI PCB全產品線垂直整合佈局的優勢，在AI時代持續拉開與同業的領先差距。

除了前瞻技術布局，臻鼎也積極推動 AI 智慧製造與綠色數位轉型，透過與工業物聯網領導廠商研華（股票代號：2395）的合作，臻鼎在數位轉型上已取得多面向成果，目前已導入研華能源管理平臺，研華亦分享智慧園區及碳管理平臺的解決方案及建置經驗。這些成果不僅僅是節能減碳的提升，更體現臻鼎在永續 ESG 方面的承諾。

研華董事長劉克振表示：「臻鼎作為 PCB 產業的領導者，也是研華長期的重要合作夥伴。我們很榮幸能攜手臻鼎推動 PCB 製造的數位化、智慧化、以及綠色轉型，從早期的數據可視化與能源管理合作開始，逐步拓展到更全面的智慧工廠應用。未來研華將持續分享在林口及昆山工廠導入 AI 技術的相關經驗，尋求與臻鼎在產線 Edge AI 與 AI Agent 的合作。我相信雙方的深度合作不僅能樹立智慧與綠色製造的新典範，也將為整個產業帶來長遠價值。」

展望未來，臻鼎將持續以「One ZDT」為核心，整合全球資源與研發能量，拓展在 PCB 與半導體雙領域的布局。臻鼎表示，PCB 跨入半導體除了象徵公司自身的重要里程碑，同時也是推動整個 PCB 產業升級的關鍵契機，作為全球 PCB 領導者，同時



也是跨足半導體的先行者，臻鼎將持續以領航者姿態，引領電子產業迎向新時代。

關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號：4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站：www.zdtco.com。

公司發言人：

凌 悸

公司治理暨投資人關係處

電話：886 3 3830101

Email: duen.t.ling@zdtco.com